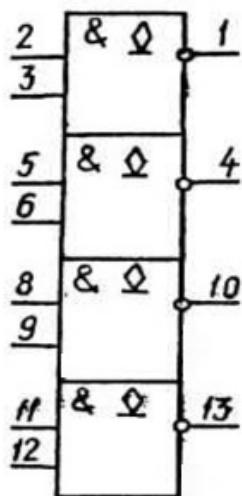


# **КР1533ЛА8, КФ1533ЛА8, ЭКФ1533ЛА8**

Микросхемы представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллекторным выходом. Содержат 64 интегральных элемента. Корпус типа 201.4-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1 - выход  $\overline{Y_1}$ ; 2 - вход информационный D1.1; 3 - вход информационный D1.2; 4 - выход  $\overline{Y_2}$ ; 5 - вход информационный D2.1; 6 - вход информационный D2.2; 7 - общий; 8 - вход информационный D3.1; 9 - вход информационный D3.2; 10 - выход  $\overline{Y_3}$ ; 11 - вход информационный D4.1; 12 - вход информационный D4.2; 13 - выход  $\overline{Y_4}$ ; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛА8, КФ1533ЛА8, ЭКФ1533ЛА8

## **Электрические параметры**

Номинальное напряжение питания ..... 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 4 \text{ мА}$  .....  $\leq 0,4 \text{ В}$

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 8 \text{ мА}$  .....  $\leq 0,5 \text{ В}$

Прямое падение напряжения на антивонном диоде .....  $\leq |-1,5| \text{ В}$

Ток потребления при низком уровне выходного

напряжения при  $U_p = 5,5 \text{ В}$  .....  $\leq 3 \text{ мА}$

Ток потребления при высоком уровне выходного

напряжения при  $U_p = 5,5 \text{ В}$  .....  $\leq 0,85 \text{ мА}$

Входной ток низкого уровня .....  $\leq |-0,1| \text{ мА}$

Входной ток высокого уровня .....  $\leq 20 \text{ мкА}$

Входной пробивной ток .....  $\leq 0,1 \text{ мА}$

Выходной ток высокого уровня .....  $\leq 100 \text{ мкА}$

Время задержки распространения сигнала

при включении .....  $\leq 28 \text{ нс}$

Время задержки распространения сигнала	
при выключении .....	≤ 54 нс
Емкость входа .....	≤ 5 пФ
Емкость выхода .....	≤ 7 пФ

## **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Напряжение питания .....	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня .....	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня .....	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход .....	5,5 В
Температура окружающей среды .....	-10...+70 °C

## **Общие рекомендации по применению**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в

пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °C.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В  $\pm 10\%$ , к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.